

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-010

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1182号）核准，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）获准非公开发行人民币普通股（A股）30,313,428股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币23.83元，募集资金总额为人民币722,368,989.24元，扣除本次发行费用人民币17,197,662.68元，募集资金净额为人民币705,171,326.56元，其中股本人民币30,313,428元，资本公积人民币674,857,898.56元。上述资金于2019年8月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门弘信电子科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2019）第350ZA0030号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）原募集资金投资项目募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金净额	截至期末累计投入募集资金	截至期末投资进度
翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	28,331.45	24,792.95	18,345.84	74.00%

项目名称	预计总投资金额	拟投入募集资金净额	截至期末累计投入募集资金	截至期末投资进度
电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	21,159.40	17,971.59	6,243.21	34.74%
FPC 前瞻性技术研发项目	7,440.80	7,252.55	5,241.98	72.28%
补充流动资金	21,000.00	20,500.04	20,524.47	100.12%
合计	77,931.65	70,517.13	50,589.95	-

注：“补充流动资金”实际投资金额超过承诺投资金额，主要系募集资金产生的利息。

（三）本次拟变更的募集资金投资项目

根据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整后，公司通过前期自有资金投入及 2020 年度发行的可转换债券募集资金，基本满足现阶段 FPC 产能建设资金需求。面对软硬结合板产能扩充的急切需求，公司拟变更“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”或“电子元器件贴装项目”）部分资金用途，在预留原募投项目待付合同款 3,301.84 万元及待购入设备款 1,848.00 万元后，将原募投项目的募集资金 7,200.00 万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，以进一步提高公司软硬结合板生产产能。本次拟变更募集资金投资涉及金额，占公司非公开发行股份募集资金净额的比例为 10.21%。

变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

（四）公司已履行的审议程序

公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募投项目计划及实际投资情况

原募集资金投资项目“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”于 2018 年立项，计划总投资金额 21,159.40 万元，其中拟投入募集资金净额 17,971.59 万元，项目实施主体为弘信电子，主要用于提高厦门工厂电子元器件贴装产能自

给率。

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，因公司产能扩充及厂房规划调整，原有规划场地已难以满足原募投项目的需求，因此公司对该募投项目区域进行重新规划，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将原募投项目实施地点变更为厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路4号弘信移动互联创业园2号楼第2层、第3层。具体内容详见公司于2020年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

截至2020年12月31日，该项目已累计投入募集资金6,243.21万元用于厂房装修和购置设备，投资进度为34.74%，募集资金余额为12,349.84万元（含利息及理财收益621.46万元），其中公司使用12,000万元所购买的理财产品尚未到期，其余募集资金均存放在公司募集资金专户。原募投项目建设已形成资产将持续用于满足公司FPC元器件贴装产能需求。

（二）变更原募投项目的原因

1、公司FPC产能在厦门工厂与荆门工厂之间调整，加之设备采购价格降低，原募投项目部分资金富余

根据公司产能战略规划，公司厦门工厂主要承接多层板、车载板及部分终端订单等，荆门产业园发挥成本及区位优势主要承接大批量的LCM订单。非公开发行募投项目中，“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”已配备包含元器件贴装在内的全制程设备，原募投项目“元器件贴装项目”中大部分产线已投资到位。在原募投项目“元器件贴装项目”已投产线充分释放产能后，公司将采取旺季将少量订单外发元器件贴装外协供应商满足弹性需求的应对措施，厦门工厂目前元器件贴装产能已基本充足。公司通过与设备供应商充分议价，本轮设备采购价格较此前预算有所降低，在满足厦门工厂元器件贴装产能基本需求后，原募投项目尚有部分募集资金富余。

2、为满足市场需求，需进一步提高软硬结合板产能

面临软硬结合板的广阔市场，公司通过可转换债券募集资金投入的募投项目

“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”释放年产能 7.2 万平米，无法满足公司将软硬结合板生产重心转移至鹰潭的产能布局需求。为抓住市场机遇，满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司拟将原募投项目“元器件贴装项目”部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”（以下简称“新募投项目”）以满足鹰潭产业园的产能建设规划。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目；
- 2、项目实施主体：江西弘信柔性电子科技有限公司；
- 3、项目建设地址：江西省鹰潭高新区白露科技园智联小镇，；
- 4、项目建设内容：提高鹰潭软硬结合板产能；
- 5、项目建设周期：本项目建设期暂定为 18 个月；

6、投资金额：本项目计划总投资金额 8,568.58 万元，其中自有资金投入 1,368.58 万元，本次募集资金投入 7,200.00 万元，项目预算投资明细如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占资金总量比例（%）
1	土地	-	0.00%
2	土建工程	500.00	5.84%
3	机器设备	7,761.64	90.58%
4	铺底流动资金	306.94	3.58%
5	建设项目总投资	8,568.58	100.00%

7、项目报批情况

（1）土地使用权

项目涉及厂房建筑物通过租赁取得。项目实施主体江西弘信与江西炬能产业园运营有限公司签订了《租赁合同》，租赁期五年。租赁期满，江西弘信如愿续租，享有优先权且时长不短于五年。

（2）项目备案、环评

本次项目将履行发改备案以及环评批复等审批程序，公司确保项目根据相关法律法规等要求充分履行外部审批程序。

8、项目经济效益：经测算，本项目全面达产后预计实现年营业收入 2.84 亿元，本项目税前投资回收期为 5.01 年，税后内部收益率为 32.47%，项目各项经

济指标良好。

（二）项目可行性分析

1、本次扩产迎合软硬结合板行业发展趋势，满足市场增长和国产替代需求

5G 时代来临，智能手机等移动电子产品升级换代需求大量释放，物联网应用愈发普遍，可穿戴设备、车联网、工业物联等领域应用落地加速，电子信息制造业迎来新一轮发展良机。同时，电子信息产品趋于多功能化、小型化以及便携化，驱使电路设计更加精细化、复杂化、空间利用更为高效化。软硬结合板可弯曲可支撑的特性，能够满足三维组装需求，可节省产品内部空间，提高产品性能。目前软硬结合板已广泛应用于 TWS 耳机等结构紧凑的消费电子，包括手机的影像模块、指纹识别模组、射频模块、柔性屏幕、按键等处。同时，汽车的倒车雷达影像系统、传感器、车用通讯系统、方向盘上连接母板的按键等模块也大量应用了软硬结合板。此外工业、军事及医疗等众多领域都需要耐用、高精度、低阻抗损失的软硬结合板。未来随着下游行业的不断增长，软硬件结合板将迎来广阔的市场前景。

在软硬结合板需求居高不下的同时，其生产工序繁多、工艺难度高、良率较低，当前下游客户主要采用台资或外资厂商的产品，国产自给率较低。公司通过扩大软硬结合板产能，为消费电子、汽车制造等众多领域提供高可靠的软硬结合板产品，满足下游不断增长的市场需求以及国内重点终端客户的软硬板国产化替代需求，助力软硬结合板的国产化。

在疫情及贸易战等不利背景下，公司软硬结合板业务仍取得较大发展，盈利能力大为改观，公司在稳步推进软硬结合板当期经营同时，亦已储备了 TWS 耳机、OLED 板以及 CCM 高端板等多元业务的订单机会，公司将“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”或“电子元器件贴装项目”）募集资金中 7,200 万元变更至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，有助于公司乘势抓住可穿戴设备持续火爆、OLED 面板国产化等下游市场持续发展的重大发展机遇，夯实公司竞争力，提升公司盈利能力。

2、进一步完善业务布局，强化规模优势

公司深耕 FPC 行业多年，已成为 FPC 领域的内资头部企业之一。依托公司已积累的软硬板设备优势、技术优势和良好的客户基础，在引入先进设备、扩大软硬结合板产能的基础上，在实现工艺升级、良率提升的同时，扩张软硬结合板业务规模，可进一步消除软硬结合板发展瓶颈，提升软硬结合板业务实力，完善公司在印刷电路板领域的业务布局，并强化公司规模优势。

在软硬结合板领域，公司已布局多年，随着公司工艺技术的不断成熟，良率的持续提升，公司已与国内多家知名摄像模组厂商开展深入合作。与此同时，公司早已在 FPC 行业确立领先地位，FPC 产品已广泛应用于显示模组、触控模组、指纹识别模组、智能手机、平板电脑等众多领域，已与多家知名电子产品制造商搭建了稳定的合作关系。未来随着本项目产能的投产，公司软硬结合板供应能力将进一步增强，并通过依托公司在 FPC 领域积累的优质的客户资源，实现 FPC 业务与软硬结合板业务的协同发展，快速开拓下游应用市场。

3、优化产品结构，顺应行业高质量发展趋势

公司已布局软硬结合板多年，在该领域已积累了设备优势、技术优势和客户基础。目前公司软硬结合板主要应用于摄像头模组，已与欧菲光等国内摄像头模组龙头企业建立了稳定的合作关系。

同时，随着我国电子信息制造业的转型升级，企业和产品竞争力明显提升，华为、小米、vivo、OPPO 等一大批国内自主品牌走向世界，与之配套的本土印刷电路板行业不断发展多层板、HDI 板、FPC 板、软硬结合板等附加值较高的产品，行业趋于高质量发展期，产能布局进一步向中国大陆转移。公司通过本项目的实施，可进一步提升软硬结合板制程能力和技术水平，以一定规模的产能为基础，助力公司开拓车载摄像头、TWS 耳机、OLED 显示等领域软硬结合板应用市场，巩固加强软硬结合板业务优势，实现公司印刷电路板业务高质量发展。

（三）项目实施面临的风险

1、新业务领域拓展不如预期的风险

本项目实施后，公司将一方面加大现有客户的业务开拓，另一方面加快潜在

客户及潜在订单导入进度。虽然经过前期的打样论证，公司已获得新的产品及订单机会，但如果未来公司新产线的导入不如预期，将导致产能的释放节奏放缓，进而致使公司无法如期获得客户新项目订单，将影响本项目的经济效益及项目的顺利实施。

2、生产线投产进度不如预期的风险

本项目是公司基于当前产业发展和市场需求，结合公司自身的业务发展情况和未来发展规划，经过长期论证后审慎决定的，预期具有良好的市场前景和经济效益。如果在项目实施过程中，宏观经济环境、行业竞争格局、产品市场需求发生不利变化，或者公司的建设投入、客户开拓、订单获取、产能消化等不如预期，将对项目的实施进度和经济效益产生不利影响。

3、行业竞争加剧带来的风险

公司鹰潭软硬结合板项目专注生产于中高端软硬结合板，扩产后将进一步满足国内市场国产替代进口的需求。面对广阔的市场需求，国内同行业其他厂商亦瞄准该市场，逐步加大投入。软硬结合板生产具有生产工艺繁多、工艺难度高、良率较低的特性，只有具备一定技术储备的公司才能抓住市场机遇、领跑行业。公司依托已积累的多年生产经验，在产线布局、设备选型、工序衔接等多方优化，提升效率和效益，但如果行业竞争加剧导致公司研发、生产等不能在竞争中保持领先，则可能导致项目经营不如预期的风险。

4、产能扩大后的管理风险

本次扩产后，江西工厂的生产规模将有大幅度增长，公司的生产、研发、管理等人员也将相应增加。随着投资项目的实施，生产规模、员工数量的迅速扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来挑战，影响公司业务的进一步发展壮大，有可能产生因公司业务规模扩大而引致的管理风险。

公司将通过不断完善内部控制制度，在利用原来累积的管理经验的同时，加大人才的引进和培养，将人才队伍的建设上升到一个新的高度，全面提升公司管理团队的管理水平和协同作战的能力，以保证扩产项目的顺利实施和公司持续稳

定发展。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事发表了如下意见：公司本次变更部分募集资金用途的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，本次变更募集资金用途履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司募集资金管理制度。本次变更部分募集资金用途事项，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本次变更募集资金用途符合公司发展经营规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；本次变更部分募集资金用途的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定。因此，监事会同意变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

保荐机构国信证券核查意见：弘信电子拟变更部分募集资金用途事项已经公司2021年1月13日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，尚需经过股东大会同意后实施，内部决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。国信证券股份有限公司同意弘信电子本次变更部分募集资金用途。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021年1月14日